



# Electroformed Bond Blades NBC-ZSERIES

## 可适用于多种加工需要的高性能切割刀片

NBC-Z系列产品具有优越的切割能力，

适用于从晶圆到基板的多重切割加工

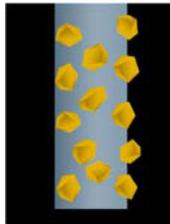
NBC-Z系列是由迪思科公司独立设计开发出的超薄、高性能切割刀片。该系列采用电铸（电镀）型结合剂，其切割能力佳且使用寿命长。另外，该产品系列种类齐全，能够广泛适用于切割加工半导体晶圆，陶瓷及CSP等半导体封装材料。

- 超薄型切割刀片，可用于深切加工及开槽加工
- 切割刀片的厚度范围为0.015 mm ~ 0.3 mm
- 通过多种颗粒大小与多种结合剂的有机结合，能够广泛适用于化合物半导体晶圆及陶瓷类电子组件的切割，开槽加工
- 既适用于切割机，也适用于切片机



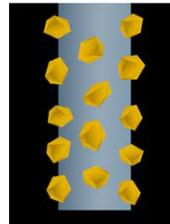
### NBC-Z型

NBC-Z型是一种具有高强度的超薄型切割刀片。适用于狭窄切割道的切割加工及开槽加工。

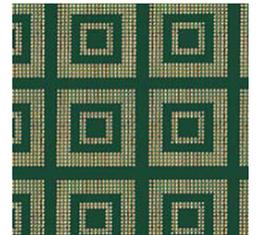


### NBC-ZB型

通过改善切割刀片的侧面形状，减少了工作物表面崩缺-chipping及倾斜切割等现象，提高了加工品质。



硅（矽）晶圆



CSP

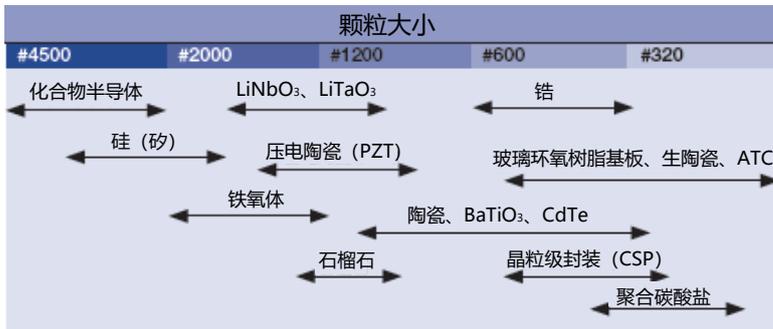
加工对象

硅（矽）晶圆、化合物半导体晶圆（GaAs、GaP等）、多种半导体封装元件、其他材料

# NBC-Z SERIES

## 加工参数

### 不同颗粒大小的应用实例



## 技术规格

<b>集中度</b>	<b>表面处理</b>	<b>厚度精度</b> ※2,3
1 低集中度	无 单面磨粒突出型	G2 ±0.005
2 标准集中度	L 研磨型 仅用于Z型	G3 ±0.002
	N 强度提高型	G 特殊规格
	V 双面磨粒突出型 仅用于ZB型	(mm)

※2 标准精度时无表示。  
※3 标准精度随品种、尺寸而变化。

※1 **NBC - Z 1 09 0 L G2 S3 T1**

<b>品种</b>	<b>颗粒大小</b>	<b>结合剂</b>	<b>切口</b> ※4	<b>刀刃形状</b> ※5
Z	13 #240 08 #1200	O 标准结合剂	S1 切口数量 4 深度 1mm	T1
ZB	14 #280 07 #1500	J 软式结合剂	S2 切口数量 8 深度 1mm	T2
	12 #320 06 #1700		S3 切口数量 16 深度 1mm	T3
	28 #360 05 #2000		深切口 切口数量 60 深度 1mm	T4
	11 #400 04 #3000		短切口 切口数量 12 深度 2mm	
	25 #500 03 #3500		S5 切口数量 40 深度 1mm	
	10 #600 27 #4000		SS 特殊规格	
	09 #700 02 #4500			
	21 #800 26 #4800			
	24 #1000			

※4 切口宽度均为0.5 mm (SS型除外) 刀片厚度大于0.04 mm时方可使用。  
※5 刀片厚度大于0.1 mm时方可使用。

※1 包括特殊规格在内的产品，有时会以BT-\*\*\*\*表示。

## 本公司的所有产品都已加入产品赔偿责任保险。

### 下订单时

在下订单时，请用户将产品的名称、外径、研削磨轮直径及数量通知本公司。另外在初次订购时，本公司销售窗口会根据不同加工要求，协助用户选择适合的产品，届时请一并提供研削材料、尺寸、形状、所用设备(装置)及其它相关加工条件等数据。

· 为了改进产品，本公司可能在未通知用户的情况下，就对产品规格进行变更，因此请仔细核对规格后再下订单。



为了安全使用本公司的各种产品

为了预防发生因研削磨轮、切割刀片(以下通称精密加工刀具)的破损而造成的各种事故和人身伤害，请严格遵守下列各注意事项。

- 请使用安全挡板(包括喷嘴外壳或外盖)。
- 在使用注有限制旋转数的精密加工刀具时，请不要超出其规定的旋转数范围。
- 在安装精密加工刀具时，请遵照设备(装置)使用说明书的规定，正确地进行安装。
- 请不要使精密加工刀具掉落地上，或发生碰撞。
- 在每次使用精密加工刀具前必须先进行检查，如果有缺口或其他破损，请停止使用。
- 在开始使用前，请先仔细阅读相关设备(装置)的使用说明书。
- 请不要使用经过改装的设备(装置)。
- 请不要使用不符合设备(装置)指定尺寸的精密加工刀具。
- 除了研削、切割及切削作业以外，请不要使用在其他用途。
- 在使用湿式研削、切割用精密加工刀具时，请使用冷却液。